

～社会実装×高専生で新たな価値を創る～

令和7年度 社会実装教育フォーラム

日時：2026年3月6日（金）～7日（土）

会場：東京工業高等専門学校

主催：東京工業高等専門学校

協力：西武信用金庫、一関工業高等専門学校、小山工業高等専門学校、長野工業高等専門学校

後援：文部科学省、国土交通省、八王子市、（一社）全国高等専門学校連合会

（一財）先端建設技術センター、（一社）日本建設機械施工協会、（一社）東京高専技術懇談会

八王子商工会議所、相模原商工会議所

【令和7年度 社会実装教育フォーラム開催要項】

本年度で14回目を迎える社会実装教育フォーラムは、おかげさまで昨年度と同じく集合形式（対面）にて開催する運びとなりました。学生の皆さんにとって、会場で審査員から直接ご指導いただくことや他高専の学生と交流することは、今後の大きな財産となることでしょう。ぜひ皆さんの挑戦意欲と努力の成果をこのフォーラムで充分に発揮してください！

また、本フォーラムでは他にも様々な企画を予定しています。詳細は決まり次第、Webサイト等でご案内いたします。

実施方法

- 1日目のファーストステージでは、全てのチームがショートオーラルとポスターで審査されます。
- 2日目のファイナルステージでは、ファーストステージの審査結果から選抜された8チームが発表し、最終審査を受け、各賞が選ばれます。

※ビデオ通話型での発表も検討します。詳しくは「その他（2）」をご覧ください。

募集

本フォーラムでは、『具体的な社会課題を解決するために、モノ・コトづくりを行い、試作したものを実社会へ実装した試み』についての発表を募集します。卒研や授業で取り組んだ内容でも構いません。

なお、「建設・社会インフラ」分野については、後述「建設現場実装プロジェクト」と連携した取組を行っています。



ポスター発表の様子

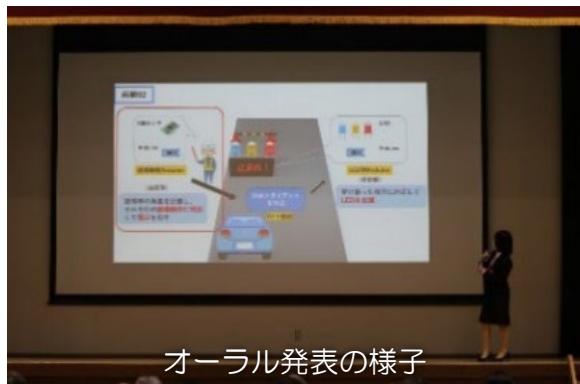
参加条件

(1) 国公私立高専の本科生・専攻科生

(2) 1チームの構成は、学生と指導教員

※学生数は1名からでも可

※同一学生の複数チームへの参加は不可



オーラル発表の様子

表 彰

令和6年度の例

- ・最優秀社会実装賞
- ・優秀社会実装賞
- ・三菱電機ロボット技術賞
- ・安川電機賞
- ・社会インフラ現場実装賞
- ・Sler 協会賞
- ・次世代センサ協議会特別賞
- ・神奈川県いのち未来戦略本部室長賞

その他多数の賞を準備しています。

参加申込

下記リンクより参加登録をお願いいたします。

<https://forms.office.com/r/822KPKwCHS>

〆切：2025年11月14日（金）17時

その他

(1) 建設現場実装プロジェクトについて

「建設・社会インフラ」分野の研究・発表については、国土交通省及び関連団体による「建設現場実装プロジェクト」の一環として準備される社会インフラ現場実装賞の選出対象となっています。選出、表彰されたチームは研究開発助成への推薦が得られます。募集テーマ等の詳細は下記リンクよりご確認ください。

<https://sieforum.tokyo-ct.ac.jp/2025/09/24/constructionsocialinfrastructure/>

また、「建設現場実装プロジェクト」では、申請・要望内容に応じて、高専学生が行う研究開発への協力や支援等を行っています。支援を希望する場合は参加登録の Forms よりお申し込みください。

(2) ビデオ通話型による発表について

ビデオ通話型とはポスターの横に PC を設置し、Microsoft Teams を使ったビデオ通話で発表、質疑応答をしていただく方法です。現地参加できないやむを得ない事情がある場合、11月7日（金）17時までにメールにてご相談ください。ただし、現地設置数に限りがありますので必ず対応できるものではありません。

(3) 学校管理下外での活動について

学校管理下以外での活動をする場合は、保険加入等必要な対策をご検討ください。

(4) ライブ配信について

本フォーラムの様子をご覧いただけるよう定点 カメラによる Microsoft Teams のライブ配信を検討しています。詳細は後日 Web サイト等でご案内いたします。

(5) Web サイトについて

社会実装教育フォーラムの Web サイトについて、下記リンクのとおりご案内いたします。過去のフォーラム（R1～R6 年度までの開催通知、結果ほか）についてもご覧いただけます。



<https://sieforum.tokyo-ct.ac.jp/>

問合せ先

東京工業高等専門学校総務課
社会実装教育フォーラム事務局
〒193-0997 八王子市樋田町 1220-2
E-mail : sieforum@tokyo-ct.ac.jp
TEL : 042-668-5398、5299、5116